

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 3 区分
【発行日】令和 7 年 4 月 7 日(2025.4.7)

【公開番号】特開 2024-96265(P2024-96265A)
【公開日】令和 6 年 7 月 12 日(2024.7.12)
【年通号数】公開公報(特許)2024-130
【出願番号】特願 2024-73131(P2024-73131)
【国際特許分類】

C 0 8 L 1 0 1 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)

10

C 0 8 K 3 / 0 1 3 (2 0 1 8 . 0 1)

【 F I 】

C 0 8 L 1 0 1 / 0 0

C 0 8 K 3 / 0 1 3

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 3 月 27 日(2025.3.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

硬化性樹脂と、無機充填材とを含み、前記無機充填材は平均粒子径が $0.07\mu\text{m} \sim 0.3\mu\text{m}$ の無機粒子 A と、前記無機粒子 A 以外の無機粒子 B と、を含み、
前記無機粒子 A の比表面積が $15\text{m}^2/\text{g}$ 以下であり、
前記無機粒子 B の体積平均粒子径が $0.5\mu\text{m} \sim 1.5\mu\text{m}$ である、
樹脂組成物。

【請求項 2】

30

前記硬化性樹脂が、エポキシ樹脂である、請求項 1 に記載の樹脂組成物。

【請求項 3】

前記樹脂組成物中の前記エポキシ樹脂の含有率が、 $0.5\text{質量}\% \sim 50\text{質量}\%$ である、請求項 2 に記載の樹脂組成物。

【請求項 4】

前記無機充填材の含有率は、前記樹脂組成物全体の $30\text{体積}\% \sim 90\text{体積}\%$ である、請求項 1 ～ 請求項 3 のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物。

【請求項 5】

前記無機粒子 A の割合が前記無機充填材全体の $3\text{質量}\% \sim 10\text{質量}\%$ である、請求項 1 ～ 請求項 4 のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物。

40

【請求項 6】

電子部品装置の封止材として用いるための、請求項 1 ～ 請求項 5 のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物。

【請求項 7】

素子と、前記素子を封止する請求項 1 ～ 請求項 6 のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物の硬化物とを備える電子部品装置。